

Pressemitteilung

22/07/2010

AT&S Ergebnisse des 1. Quartals 2010/11

Mit einem der besten ersten Quartalsergebnisse startet AT&S in das Wirtschaftsjahr 2010/11. Die AT&S Gruppe erreichte mit einer Erlössteigerung um 14% im Vergleich zum letzten Quartal nicht nur ein solides Ergebnis vor Steuern, sondern übertraf auch die internen und externen Erwartungen bei weitem. In der Folge konnte die EBIT-Marge verbessert und die Nettoverschuldung deutlich gesenkt werden.

Die Erlöse aus dem ersten Quartal 2010/11 konnten im Vergleich zum letzten Quartal des Vorjahres um 14% gesteigert werden und liegen sogar um 37% höher als im Jahr davor. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das erste Quartal 2010/11 beläuft sich – bereinigt um außergewöhnliche Aufwendungen – auf 10,1 Mio. Euro und liegt damit 14% über dem Vorquartal und hat somit ungefähr das Niveau vor der Finanzkrise erreicht.

	1. Quartal 2010/11	Marge	4. Quartal 2009/10	Marge
Umsatzerlös*	113,9		99,7	
Bruttogewinn*	19,8	17,4%	12,8	12,9%
EBITDA*	21,9	19,3%	17,3	17,30%
Betriebsergebnis*	10,1	8,9%	6,2	6,20%
Ergebnis vor Steuern	10,1	8,9%	4,5	4,5%
Konzernergebnis	7,57	6,6%	2,7	2,8%
EPS**	0,33		0,12	
Anzahl der Aktien, Durchschnitt***	23.323		23.323	

In EUR Millionen

* in EUR Millionen exkl. Einmaleffekte

** in EUR

*** in 1.000 Stück

Obwohl die Ausgaben im Bereich der Nettoinvestitionen von 2 Mio. Euro im vorigen Quartal auf 19 Mio. Euro im ersten Quartal 2010/11 gestiegen sind, fiel der Nettoverschuldungsanteil des Unternehmens um mehr als 24 Prozentpunkte auf einen Nettverschuldungsgrad von 62%. „Die Geschäftsergebnisse des ersten Quartals 2010/11 sind sehr vielversprechend“, erklärt CEO Andreas Gerstenmayer. „Unser Fokus auf den High-End-Markt macht sich mehr als bezahlt, vor allem weil sich die Wirtschaft wesentlich schneller erholt, als wir noch vor drei Monaten angenommen haben.“

AT&S plant daher die Kapazitäten in Shanghai (China) und Nanjangud (Indien) weiter zügig auszubauen. Großen Wert legt das Unternehmen dabei an allen Standorten weltweit auf das Thema Umwelt. „Im vergangenen Quartal sind wir beispielsweise in China von der Wasserbehörde in Shanghai als Vorzeigeunternehmen für unseren außerordentlichen Beitrag zur Wassereinsparung ausgezeichnet worden“, meint Gerstenmayer.

„Zurzeit evaluieren wir zudem verschiedene Möglichkeiten der Investition in unser Werk in Leoben-Hinterberg. Die Schwächung des Euro könnte uns dabei helfen, die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu verbessern“, erläutert Gerstenmayer. „In Indien müssen wir hingegen noch unsere Hausaufgaben erledigen, da uns hier der starke Dollar nicht unbedingt unterstützt. Insgesamt bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir uns – solange der Ausblick auf die Weltwirtschaft positiv bleibt – sehr gut positioniert haben, um unsere Wertschöpfung für unsere Kunden weiter zu verbessern und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern. Wir haben daher auch unsere positive Aussicht für das Wirtschaftsjahr entsprechend nach oben angepasst.“

AT&S beschäftigt am 30. Juni 2010 6.541 Mitarbeiter an Standorten in Österreich, Indien, China, Korea und in insgesamt 16 Vertriebsbüros.

AT&S bringt innovative Lösung im Bereich der Leiterplatten zur Serienreife

Gerade beim Smartphone stellt AT&S einmal mehr ihre technologische Vorreiterrolle unter Beweis, denn hier gilt es, mechanische, elektrische und optische Herausforderungen zu lösen: das Gerät soll stabil sein, alle bestehenden Mobilnetze in Verbindung mit GPS, Digitalkamera, Touchscreen, Internetdiensten und vielem mehr verbinden und gleichzeitig muss es vor allem auch noch optisch „hype“ sein. Diese Anforderungen wirken sich auch massiv auf die Leiterplatte aus. „AT&S investiert gezielt in die auf kundenspezifische Bedürfnisse orientierte Weiterentwicklung von Leiterplatten“, erklärt Andreas Gerstenmayer. „Wir stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Verfügung, um die optimale Lösung für ihr Produkt zu finden.“

Um beispielsweise die verschiedenen Frequenzen der Mobilnetze abdecken zu können, liegt die Lagenanzahl der Leiterplatte zwischen 8 und 14 Lagen, die Dicke der gesamten Leiterplatte beträgt aber nur zwischen 0,6 und 1,2 Millimeter. Damit bleibt für die Isolationsschichten zwischen den leitenden Kupferlagen nur noch eine Dicke von 30 – 50 μm – hier sind spezielle Materialien gefragt, die gleichzeitig flexibel und robust sein müssen. Denn trotz dieser geringen Dicken muss die Leiterplatte mechanisch stabil sein und darf sich weder verformen noch brechen. Zum Vergleich: ein normales Blatt Papier (80g/ m^2) hat eine Dicke von 100 μm .

Die elektrische Verbindung der immer kleineren Bauteile (z.B. Kondensatoren, Widerstände in SMD Bauweise mit einer Größe von 254 μm x 127 μm) erfolgt durch die Kupferlagen (Leiterzüge) und durch Laser- oder Mechanische Bohrungen, die ebenfalls mit Kupfer versehen werden. Um in der Multilayer-Leiterplatte alle Lagen selektiv miteinander verbinden zu können, werden allerdings bereits fast nur mehr Laserbohrungen (sogenannte Microvias) verwendet. Davon sind pro Leiterplatte – je nach Anforderung – 10.000 bis 15.000 notwendig. Zum Vergleich: die ersten Leiterplatten für Mobiltelefone hatten gerade einmal 500 – 1500 dieser Laserbohrungen. Die Anzahl der Bohrungen steigt weiter, um immer neue Anwendungen der Mobilgeräte zu ermöglichen und immer kleinere und komplexere Bauteile einzubinden.

AT&S Forschungsarbeit zu EU-Projekt HERMES[®] ausgezeichnet

Das von AT&S initiierte und von der EU geförderte HERMES[®]-Projekt forscht an der nächsten technischen Innovation bei Leiterplatten – einer neuen Packaginglösung für Halbleiter, die weit über die heutigen Verbindungsmöglichkeiten hinausgeht. Mit der Industrialisierung dieser Technologie öffnet sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Medizinbereich – beispielsweise neue Generationen von Hörgeräten – und in funktionellen Modulen wie etwa GPS (Global Positioning System).

Die Zukunft der Mobile Device Produkte (Handys, Digitalkameras, etc.) liegt in der Steigerung der Leistung und der Integration neuer Funktionen. Gerade diese Leistungssteigerung wird HERMES[®] ermöglichen. Im Rahmen der IPC APEX EXPO[™], der weltweit wichtigsten technischen Konferenz und Messe für die Leiterplatten- und Elektronikbaugruppen-Industrie, in Las Vegas wurde der Technologiebeitrag von

HERMES[®] als „Best International Conference Paper“ ausgezeichnet. Die Forschungsarbeit „Industrial PCB Development Using Embedded Passive & Active Discrete Chips Focused on Process and DfR“ ist das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit von Thales Corporate Services und AT&S innerhalb des EU-geförderten HERMES[®]-Projektes.

© Copyright 2010. IPC — Association Connecting Electronics Industries®, Bannockburn, Ill., US

Über AT&S

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der leistungsstärksten Leiterplattenproduzenten. Insbesondere im höchsten Technologie-segment, den HDI-Microvia-Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit drei Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul).

Weitere Infos auch unter www.ats.net

Presserückfragen:

Martin Theyer, Director Strategy Development & Communication

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

+43 3842 200-5909, m.theyer@ats.net, www.ats.net